

Okamoto

SEMICON[®]

セミコンジャパン2011のご案内 Japan2011

2011年12月7日(水)～9日(金) / 幕張メッセ

Booth Number
4B-401

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、今年も幕張メッセにてセミコンジャパン2011が開催されます。弊社は近年注目が集まるTSVプロセス、グリーンデバイス用難削材、太陽光発電用の加工装置技術、サファイアインゴット加工の紹介をいたします。ご多忙中誠に恐縮ではございますが、弊社小間にご来場賜ります様お願い申し上げます。

平成23年11月吉日

敬具

株式会社 岡本工作機械製作所
代表取締役社長 西本 実男

出展内容

TSV用加工 TSVプロセスへの取り組みと開発装置の紹介

薄厚化技術 インラインバックグラインダーGDM300 25um量産加工対応

グリーンデバイス加工 サファイア、GaN 及び SiC 向け加工機及びプロセスの提案

太陽光発電用加工 全自動Siインゴット加工装置及びプロセスの提案

サファイアインゴット加工 LED関連、難削材加工

岡本工作機械

<http://www.okamoto.co.jp>